

# 深圳市江波龙电子股份有限公司

## 投资者关系活动记录表

编号：2023-010

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	景顺长城、长城证券、招商资管、汇添富基金、中融基金、信达澳银、申万菱信、九泰基金、鼎和财产、富荣基金、恒邦兆丰、博时基金、摩根士丹利、混沌投资、招商证券、融通基金、银华基金、贝莱德基金、南土资产共 19 家机构
时间	2023 年 7 月 10 日 (周一) 15:00~16:00 2023 年 7 月 12 日 (周三) 10:00~11:00 2023 年 7 月 12 日 (周三) 15:00~16:00 2023 年 7 月 14 日 (周五) 10:00~11:00 2023 年 7 月 14 日 (周五) 16:00~17:00
地点	深圳市南山区科发路 8 号金融基地 1 栋 8 楼会议室
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书 许刚翎 董事会办公室 苏阳春

<p>投资者关系活动 主要内容介绍</p>	<p><b>1、基于原厂减产的影响，晶圆价格是否开始反弹？</b></p> <p>答：原厂减产效应，对下游厂商的采购有正向的拉动。存储晶圆的价格磨底过程需要持续关注市场各方力量的联动。</p> <p><b>2、公司的存货占比构成情况？</b></p> <p>答：在公司的库存结构里面，晶圆的占比更高一些，由于其能够应用于多种不同的细分场景，灵活性会比成品更好一些，这在一定程度上保留了未来公司在产品选型等方向上的灵活性，有助于提升公司的竞争力。</p> <p><b>3、公司库存的趋势展望，公司二季度库存环比一季度是否上升？</b></p> <p>答：目前公司二季度库存数据还在统计中。公司采购策略主要以大客户的需求为牵引，结合市场综合因素判断。在审慎，及时和以市场产品为准的原则指导下，公司库存水平保持合理水位。</p> <p><b>4、公司 SLC NAND Flash 研发团队来源哪里，为什么这么快起量？</b></p> <p>答：2019 年，公司于上海研发中心建设芯片设计研发团队，主要聚焦 SLC NAND Flash 等小容量存储器芯片设计。基于公司在车载市场及工业领域的良好基础，公司 SLC NAND Flash 存储芯片研发成功后，成功导入到已布局的客户当中，因此其营收增长速度较快。</p> <p><b>5、公司目前的备货策略是什么样的？</b></p> <p>答：公司库存余额自 2022 年第三季度末达到高值后，至 2023 年第一季度，略有下降。为满足大客户的需求，保持持续稳定的供应能力，在满足交付的同时，公司亦兼顾存货的流动性，保持一定的库存水位。</p> <p><b>6、公司收购力成苏州的具体原因？未来是否会进行其他方向的收购？</b></p>
---------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

答：随着公司大客户的不断增多，其对于公司封测能力自主可控的重要性会更高，因此公司需要补强封测这一块布局。力成科技是全球最大的第三方存储芯片封测厂商，其存储芯片封测工艺和技术全球领先。力成苏州是力成集团的全资子公司，是国内首家拥有 12'晶圆生产技术及多层晶片叠封技术的先进封装企业，突破之前专注于生产制造的运营模式，除了保持已有的半导体封装测试外，现又引进了贴片生产线，其产品范围除了闪存外，还扩展到其他形式的记忆体，逻辑元器件等。交易完成后，公司将持续为力成苏州赋能，一方面加强其现有业务，另一方面提升其产能利用率。通过本次收购，公司将进一步提升存储芯片封装测试能力，完善产业链布局，强化与存储晶圆原厂的业务合作关系。关于未来的收购计划，请以公司公告为准。

**7、公司目前的营收占比构成情况？**

答：公司的营收结构大致上延续了 2022 年四季度的情形。

**8、存货涨跌对公司盈利的影响？**

答：目前公司以大客户市场为主，与大客户之间的交易较为稳定，公司以存储器的研发生产销售为主营业务，存货涨跌属于公司经营因素之一，对公司的盈利会产生被动影响但并不是公司的主动经营策略。

**9、公司是否涉及 HBM 技术领域？**

答：HBM 技术属于内存芯片设计技术与内存模组应用的结合。公司目前暂未涉及相关的内存芯片设计研发，但公司将保持对该技术的持续关注，并在产品应用层面上提前开展相关的研发布局工作。

**10、目前数据中心下单的模式是怎么样的？**

答：目前在行业信创领域，比如金融、能源、交通及运营商等行业，其模式较为传统，通过大量的研发及样品验证，

以及技术标准的认证审查等导入过程，需要半年以上的时间。

**11、公司企业级 SSD 产品放量的节奏？**

答：公司企业级 SSD 期望今年内能够在部分大客户中实现突破，取得批量的订单。期望明年能够正常延续今年的业务节奏，取得进一步进展。

**12、三季度公司的净利润及毛利率是否能够恢复到正常水平？2024 年市场恢复力度？**

答：从目前趋势来看，公司 2023 年第三季度的经营挑战仍存，短期内的晶圆原厂价格以及生产策略的调整以及下游消费市场的接受程度需要密切关注。目前智能化浪潮远未终结，汽车电子、医疗设备等行业对存储的需求在不断增长，叠加原厂减产的因素，明年市场恢复情况可能会更明显一些。

**13、公司的库存周转率是多少？**

答：近几年公司的周转率有所下降，2022 年的库存周转天数在 180 天左右。

**14、下游客户向公司采购的模式是什么样的？**

答：在与客户的合作策略上，公司的供应链管理部门与业务部门均具备丰富的经验，主要根据不同客户的信用额度，备货规模等综合因素，密切关注客户 Forecast 变动并安排实际的投入生产。

**15、公司近期收购的 SMART 巴西及力成苏州在技术方面能达到什么领域，其产能情况如何？**

答：SMART 巴西目前主要集中于消费级的嵌入式存储、SSD 存储、内存条，其在存储芯片封装测试和存储模组 SMT 制造方面，拥有满足国际客户严格要求的工艺流程管控、品质管控和系统管控能力。供应链层面上，巴西政府目前正在推行相关集成电路扶持计划，有助于公司在巴西市场的拓

展。公司在巴西市场的发展稳定后，未来将积极考虑部署更多产能。力成苏州是力成集团的全资子公司，是国内首家拥有 12'晶圆生产技术及多层晶片叠封技术的先进封装企业，未来公司将对其在业务上积极赋能，创造更多新的业务机会。

**16、力成苏州能否做 HBM 的封装？**

答：目前力成苏州主要以存储芯片的封测业务为主，以及部分逻辑芯片封测业务，暂不涉及 HBM 封装领域。

**17、目前下游客户需求是否有回暖迹象？**

答：目前部分客户采购有所恢复，但是，是否形成明显的趋势有待观察。

**18、随着人工智能的落地，智能手机及物联网等市场对存储的需求是否有拉动？**

答：随着智能手机存储全面进入到 UFS 时代后，人工智能对手机端的一些辅助应用的要求，比如在数据传输速度、存储空间等方面，UFS 能够比较好地满足。

**19、力成苏州在国内的客户主要有哪些？**

答：目前力成苏州国内的客户主要以行业 tier 1 大客户为主，未来力成苏州将继续为客户提供更加优质的封测服务。

**20、力成苏州 NAND Flash 和 DRAM 业务都有布局吗？**

答：目前力成苏州主要以 NAND Flash 和 DRAM 存储芯片的封测业务为主，以及部分逻辑芯片封测。

**21、力成苏州未来的投入规划？产值规模能达到多少？**

答：公司将结合产品特点，封测要求和客户意见，采取各种措施，持续提高苏州力成产能利用率，提升业务规模。未来力成苏州将继续为客户提供更加优质的封测服务。

**22、公司两起收购的进度如何，对公司报表是否有影**

响？

答：关于力成苏州收购项目，出于谨慎性原则，公司将充分考虑相关规定，对力成苏州进行最近一期审计工作，并依法及时履行适当的审议程序。关于 SMART 巴西收购项目，目前双方已签署《股权购买协议》，鉴于 SMART 巴西为注册在巴西的企业，在 SMART 巴西依据《股权购买协议》正式交割前，卖方将确保 SMART 巴西提供一年又一期的审计报告，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议并提交股东大会审议。如进展顺利，预计在今年内完成交割，具体收购进展情况以公司披露的公告为准。两起收购交易完成后，公司将间接控股力成苏州及 SMART 巴西，并将其纳入公司合并报表范围。

### **23、公司各产品线的营收进展情况？**

答：在宏观压力仍存，经营环境充满挑战的背景下，目前公司总体经营情况稳定，营收目标实现基本符合预期。嵌入式存储产品线的收入占公司营收比重较大，但公司产品结构及客户结构得到不断优化，例如公司对 Lexar(雷克沙)品牌业务进行了整合与完善，其品牌影响力在新的区域市场得到了挖掘，如南欧地区、纽澳地区及东南亚地区。此外在公司移动存储产品线业务中，公司与国际大客户的业务合作也保持了良好的势头，有所突破。

### **24、公司 UFS 产品在智能手机市场的应用情况？**

答：智能手机嵌入式存储已进入 UFS 时代，5G 手机默认搭配 UFS。经过 3 年多研发，江波龙全自主固件系统的 UFS2.2 嵌入式存储产品已实现量产出货，已发布最新标准的商业级 UFS3.1 产品并开始量产。

### **25、公司在信创市场具备的优势？以及现有团队的优势？**

答：首先，公司重视信创行业，并采取稳扎稳打的发

	<p>展战略，从 2020 年开始组建研发团队，建设上海研发总部，主要聚焦于企业级及工规级高端存储器的研发。其次，从产品力来看，企业级服务器对于产品本身的性能要求非常高，经过多年的技术积累，公司具备了较强的技术优势。从研发团队来看，公司的核心研发骨干具备企业级服务器产品端到端的成功项目经验及技术。综合上述优势，公司对企业级存储业务的未来发展具备较强的信心。</p>
附件清单（如有）	无